

**POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA**



**URZĄD
PATENTOWY
PRL**

**Opis SŁUŻBOWY
OPIS PATENTOWY**

68130

Patent dodatkowy
do patentu 66067

Zgłoszono: 19.I.1971 (P 145 715)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 29.IX.1973

Kl. 21g,10/02

MKP H01g 1/02

CZYTELNIA

Urzędu Patentowego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Twórca wynalazku: Zdzisław Tadej

Właściciel patentu: Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex”, Kutno
(Polska)

**Sposób hermetyzacji podzespołów elektronicznych, zwłaszcza
kondensatorów**

1

Wynalazek dotyczy ulepszenia sposobu hermetyzacji podzespołów elektronicznych, zwłaszcza kondensatorów według patentu nr 66 067.

Zgodnie z wynalazkiem opatentowanym za nr 66 067, do dolnej części formy wypełnionej odpowiednią porcją masy zalewowej dociska się część górną, w której otworach kształtujących obudowę umieszcza się podzespoły, podwieszając je poprzez zagięcie końcówek.

Wadą tego sposobu jest trudność prostowania końcówek, w celu oddzielenia obudowanego podzespołu od płyty mocującej.

Celem wynalazku jest sposób zamocowania podzespołu elektronicznego, zwłaszcza kondensatora, podczas wykonywania jego obudowy bez konieczności zaginania końcówek.

Sposób według wynalazku polega na tym, że do dolnej części formy, wypełnionej porcją masy zalewowej, dociska się część górną, w której otworach przelotowych kształtujących obudowę umieszcza się sprężyste płytki, wygięte na kształt litery „U”, na której osadza się hermetyzowane podzespoły.

Wynalazek umożliwia umieszczenie kondensatora w otworze przelotowym formy bez konieczności mocowania go za końcówki.

Przedmiot wynalazku jest dokładniej wyjaśniony na podstawie jego przykładu zastosowania, uwidocznionym na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia

2

formę przed złożeniem, a fig. 2 przedstawia formę po jej złożeniu.

Płytkę **1** wykonaną z folii aluminiowej, laminowanej po jednej stronie folią poliestrową, a po drugiej papierem, umieszcza się w otworze przelotowym **2** górnej części formy **3**, wyginając ją na kształt litery „U” w ten sposób, aby folia poliestrowa była wewnątrz. Następnie wkłada się do otworu przelotowego **2** zwiwkę **4** kondensatora z metalizowanego poliestru, która osiada na płytce **1**, a odpowiednie położenie końcówek **5** i zwiłki **4** zapewnia płyta rastrowa **6**. Tak przygotowaną górną część formy **3** zawiesza się nad dolną częścią formy **7** o kształcie tacy, w komorze próżniowej. Po odgazowaniu zwiłki **4** i kauczuku silikonowego **8**, którym jest wyłożona taca **7**, wlewa się do niej odpowiednią porcję masy zalewowej **9**, wykonanej z żywicy epoksydowej. Z kolei, górną część formy **3** osadza się w tacy **7** na wykładzinie kauczukowej **8**. Wówczas masa zalewowa **9** wpływając do otworu przelotowego **2** górnej części formy **3** pokrywa zwiwkę **4**. Po utwardzeniu masy zalewowej **9** zdejmuje się z końcówek **5** płytę rastrową **6** i wypycha się obudowaną zwiwkę **4** z otworu przelotowego **2** górnej części formy **3**.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób hermetyzacji podzespołów elektronicznych, zwłaszcza kondensatorów, polegający na tym, że

do dolnej części formy, wypełnionej porcją masy zalewowej, dociska się część górną, w której otworach kształtujących obudowę umieszcza się podzespoły, według patentu nr 66 067, **znamienny** tym,

że podzespoły (4) osadza się na płytce (1) w otworze przelotowym (2) formy (3), przy sile tarcia płytki (1) o ścianki formy (3) co najmniej równej sile ciężkości podzespołu (4), przyłożonej do płytki (1).

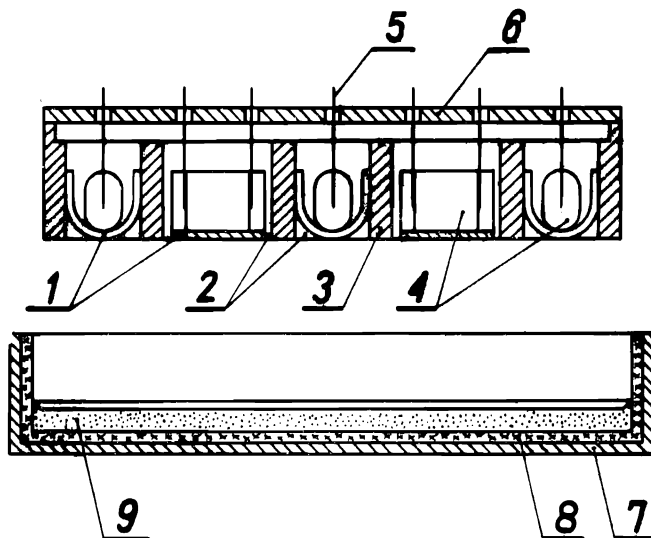


Fig. 1

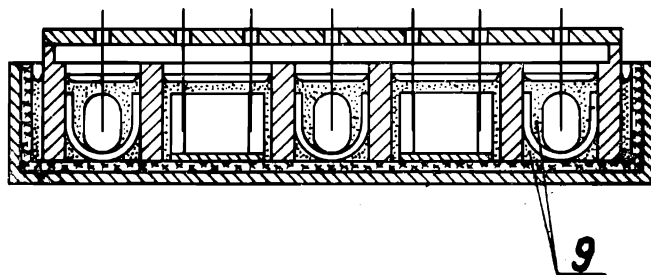


Fig. 2

Cena zł 10,—